



tesa® 60745

製品案内



基材レス両面粘着テープ (トランスファーテープ) [熱伝導性] 100µm厚 / 白

製品の説明

tesa® 60745は、基材レスのアクリル系粘着剤 (トランスファーテープ) です。熱伝導性フィラーを配合しているため、優れた熱伝導性と接着特性を併せ持ちます。

ディスプレイやMLB (高密度多層プリント基板) など、電子機器の熱源となるデバイスと熱拡散材料を接着でき、同時にZ方向に対して熱を伝えることが可能です。

特徴

- テープ厚 : 100µm
- 色 : 白
- ライナー : ダブル(PET)
- 様々な素材の被着体に対し高い接着性能を示します。
- Z方向への熱伝導性に優れます。
- 濡れ性に優れます。
- 電気絶縁性に優れます。

用途

- 熱伝導性が求められる各種デバイス部品の固定、アセンブリ
- 熱源 (MLBやFPCなど) からヒートスプレッダへの熱伝導材料
- 熱伝導性が求められるディスプレイの固定
- ベイパーチャンバーやヒートパイプの固定、アセンブリ
- 5Gミリ波アンテナの固定、アセンブリ
- グラファイトシートの貼り合わせ

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

• 基材	無し	• 総厚	100 µm
• 粘着剤	アクリル系	• 色	白
• ライナー	PETフィルム	• ライナーの色	透明

特性 / 性能

• Z方向の熱伝導性	1 W/mK	• 絶縁破壊電圧	3.5 KV
• 濡れ	81 %		



tesa® 60745

製品案内

被着体ごとの粘着強さ

- ・ スチール粘着力 (初期) 4.5 N/cm

備考

ASTM D5470に準拠し熱伝導率を測定

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=60745>